

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 2 月 5 日(05.02.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/016352 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 133/04 (2006.01) *C09J 163/00* (2006.01)
C09J 7/00 (2006.01) *C09J 175/04* (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01) *H01L 21/301* (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/070364
- (22) 国際出願日: 2014 年 8 月 1 日(01.08.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-161694 2013 年 8 月 2 日(02.08.2013) JP
- (71) 出願人: リンテック株式会社(LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 土山 さやか(TSUCHIYAMA, Sayaka); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 市川 功(ICHIKAWA, Isao); 〒1730001 東京都板橋区本町 2 3 - 2 3 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 前田・鈴木国際特許業務法人(MAEDA & SUZUKI); 〒1010051 東京都千代田区神田神保町

一丁目 1 番地 1 7 東京堂神保町第 3 ビル 2 階 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION, ADHESIVE SHEET, AND METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 接着剤組成物、接着シートおよび半導体装置の製造方法

(57) Abstract: Provided are an adhesive composition capable of joining with sufficient adhesive strength and capable of achieving high package reliability in a semiconductor device in particular, an adhesive sheet having an adhesive layer composed of the adhesive composition, and a method for manufacturing a semiconductor device that uses the adhesive sheet. The adhesive composition according to the present invention is characterized in comprising an acrylic polymer (A) having a weight-average molecular weight (Mw) of 350,000 or higher obtained by polymerizing an acrylic monomer by living radical polymerization using an organotellurium-containing compound as the polymerization initiator, an epoxy thermosetting resin (B), and a thermosetting agent (C).

(57) 要約: 十分な接着強度で接合でき、特に半導体装置において高いパッケージ信頼性を達成できる接着剤組成物および該接着剤組成物からなる接着剤層を有する接着シートならびに該接着シートを用いた半導体装置の製造方法を提供する。本発明に係る接着剤組成物は、有機テルル含有化合物を重合開始剤として用いるリビングラジカル重合法により、アクリル系モノマーを重合して得られる重量平均分子量 (Mw) が 35 万以上のアクリル重合体 (A)、エポキシ系熱硬化性樹脂 (B) および熱硬化剤 (C) を含むことを特徴としている。



WO 2015/016352 A1